

2017-2022年中国半导体市 场需求状况分析及投资前景建议报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国半导体市场需求状况分析及投资前景建议报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/X05043O3Y5.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来全球半导体行业发展速度趋缓，唯独中国一枝独秀，多年来市场需求均保持快速增长。中国半导体市场需求占全球比例持续攀升，已由2003年的18.5%提升到2014年的56.6%，中国已成为全球半导体消费的中坚力量。

2003-2014年全球半导体市场需求各地区占比数据来源：公开数据整理

2015年全球地区半导体市场规模及增长率数据来源：公开数据整理

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国半导体市场需求状况分析及投资前景建议报告》共十二章。首先介绍了半导体行业市场发展环境、半导体整体运行态势等，接着分析了半导体行业市场运行的现状，然后介绍了半导体市场竞争格局。随后，报告对半导体做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体产业有个系统的了解或者想投资半导体行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2014-2016年全球半导体产业发展分析

1.1 2014-2016年世界半导体市场总体分析

1.1.1 产业发展历程

1.1.2 全球市场规模

1.1.3 市场竞争格局

2014年全球十大半导体设备商市场份额数据来源：公开数据整理

1.1.4 行业整并形势

1.1.5 未来发展趋势

1.2 2014-2016年美国半导体市场发展分析

1.2.1 市场发展规模

1.2.2 行业并购热潮

1.2.3 政策助力发展

- 1.2.4 产业发展战略
- 1.2.5 未来发展前景
- 1.3 2014-2016年韩国半导体市场发展分析
 - 1.3.1 全球产业地位
 - 1.3.2 市场发展动力
 - 1.3.3 竞争形势分析
 - 1.3.4 产业创新模式
 - 1.3.5 设备产业战略
 - 1.3.6 未来市场发展
- 1.4 2014-2016年日本半导体市场发展分析
 - 1.4.1 行业发展历史
 - 1.4.2 产业发展现状
 - 1.4.3 市场竞争格局
 - 1.4.4 行业发展经验
- 1.5 2014-2016年其他国家半导体产业发展分析
 - 1.5.1 英国
 - 1.5.2 德国
 - 1.5.3 印度

第二章 中国半导体产业发展环境分析

- 2.1 政策环境
 - 2.1.1 智能制造政策
 - 2.1.2 集成电路政策
 - 2.1.3 半导体产业规划
 - 2.1.4 “互联网+”政策
- 2.2 经济环境
 - 2.2.1 国民经济运行状况
 - 2.2.2 工业经济增长情况
 - 2.2.3 固定资产投资情况
 - 2.2.4 经济转型升级形势
 - 2.2.5 宏观经济发展趋势
- 2.3 社会环境

- 2.3.1 互联网加速发展
- 2.3.2 智能产品的普及
- 2.3.3 科技人才队伍壮大
- 2.4 技术环境
 - 2.4.1 忆阻器的研发
 - 2.4.2 激光连接研发
 - 2.4.3 可编程的层级
 - 2.4.4 石墨烯的推动
 - 2.4.5 印刷电路发展
 - 2.4.6 无线芯片技术

第三章 2014-2016年中国半导体行业发展分析

- 3.1 中国半导体产业发展综述
 - 3.1.1 行业基本概述
 - 3.1.2 行业发展意义
 - 3.1.3 市场形势分析
 - 3.1.4 产业发展基础
 - 3.1.5 上游行业发展
- 3.2 2014-2016年中国半导体市场发展规模
 - 3.2.1 产业发展规模
 - 3.2.2 市场规模现状
 - 3.2.3 销售市场规模
 - 3.2.4 产业资金投资
- 3.3 2014-2016年中国半导体技术研发进展
 - 3.3.1 技术发展现状
 - 3.3.2 技术发展方向
 - 3.3.3 技术发展趋势
- 3.4 中国半导体行业发展问题分析
 - 3.4.1 产业发展困境
 - 3.4.2 开发速度放缓
 - 3.4.3 市场垄断困境
- 3.5 中国半导体市场发展应对策略

- 3.5.1 企业发展战略
- 3.5.2 突破垄断策略
- 3.5.3 加强技术研发

第四章 2014-2016年中国半导体行业上游半导体材料发展分析

- 4.1 半导体材料相关概述
- 4.2 2014-2016年全球半导体材料发展状况
 - 4.2.1 市场发展回顾
 - 4.2.2 市场现状分析
 - 4.2.3 行业研发动态
- 4.3 2014-2016年中国半导体材料行业运行状况
 - 4.3.1 产业发展特点
 - 4.3.2 行业销售规模
 - 4.3.3 市场格局分析
 - 4.3.4 产业转型升级
 - 4.3.5 行业成果分析
- 4.4 主要半导体材料市场发展分析
 - 4.4.1 硅片
 - 4.4.2 靶材
 - 4.4.3 掩膜版
 - 4.4.4 光刻胶
 - 4.4.5 电子气体
 - 4.4.6 封装材料
 - 4.4.7 高纯化学试剂
 - 4.4.8 化学机械研磨
- 4.5 半导体材料行业存在的问题及发展对策
 - 4.5.1 行业发展滞后
 - 4.5.2 产品同质化严重
 - 4.5.3 供应链不完善
 - 4.5.4 产业创新不足
 - 4.5.5 行业发展建议
- 4.6 半导体材料产业未来发展前景展望

- 4.6.1 行业发展趋势
- 4.6.2 行业需求分析
- 4.6.3 行业前景分析

第五章 2014-2016年中国半导体行业中游集成电路发展分析

- 5.1 2014-2016年中国集成电路发展总况
 - 5.1.1 全球市场规模
 - 5.1.2 产业政策推动
 - 5.1.3 主要应用市场
 - 5.1.4 市场规模现状
- 5.2 2014-2016年中国IC设计产业发展分析
 - 5.2.1 产业发展历程
 - 5.2.2 市场发展现状
 - 5.2.3 市场竞争格局
 - 5.2.4 企业专利情况
 - 5.2.5 国内外差距分析
- 5.3 2014-2016年中国晶圆制造行业发展分析
 - 5.3.1 晶圆制造工艺
 - 5.3.2 晶圆加工技术
 - 5.3.3 国外发展模式
 - 5.3.4 国内发展模式
 - 5.3.5 企业竞争现状
 - 5.3.6 市场布局分析
 - 5.3.7 产业面临挑战
- 5.4 2014-2016年中国芯片封装测试行业发展分析
 - 5.4.1 封装技术介绍
 - 5.4.2 芯片测试原理
 - 5.4.3 主要测试分类
 - 5.4.4 封装市场现状
 - 5.4.5 封测竞争格局
 - 5.4.6 发展面临的问题
 - 5.4.7 技术发展趋势

- 5.5 中国集成电路产业发展的问题及对策
 - 5.5.1 发展面临的问题
 - 5.5.2 发展对策分析
 - 5.5.3 产业突破方向
 - 5.5.4 “十三五”发展建议
- 5.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析
 - 5.6.1 全球市场趋势
 - 5.6.2 国内行业趋势
 - 5.6.3 行业机遇分析
 - 5.6.4 市场规模预测

第六章 2014-2016年中国半导体行业中游半导体设备发展分析

- 6.1 2014-2016年半导体设备行业发展分析
 - 6.1.1 产业链位置
 - 6.1.2 产业发展地位
 - 6.1.3 市场发展主体
- 6.2 2014-2016年全球半导体设备市场发展形势
 - 6.2.1 全球销售规模
 - 6.2.2 行业投资规模
 - 6.2.3 重点设备企业
 - 6.2.4 发展潜力分析
- 6.3 2014-2016年中国半导体设备市场发展现状
 - 6.3.1 发展形势分析
 - 6.3.2 市场规模分析
 - 6.3.3 销售市场格局
 - 6.3.4 重点企业发展
 - 6.3.5 巨大替代空间
- 6.4 半导体设备核心工艺发展分析
 - 6.4.1 光刻机
 - 6.4.2 刻蚀机
 - 6.4.3 化学气相沉积
- 6.5 中国半导体设备企业面临的发展障碍

- 6.5.1 技术壁垒
- 6.5.2 资金壁垒
- 6.5.3 产业链壁垒
- 6.6 中国半导体设备市场投资机遇分析
 - 6.6.1 行业投资机会分析
 - 6.6.2 建厂加速拉动需求
 - 6.6.3 国内实现进口替代
 - 6.6.4 产业政策扶持发展

第七章 2014-2016年中国半导体行业下游应用领域发展分析

- 7.1 物联网
 - 7.1.1 产业链的地位
 - 7.1.2 市场规模现状
 - 7.1.3 关键技术分析
 - 7.1.4 市场并购动态
 - 7.1.5 未来发展前景
- 7.2 智能手机
 - 7.2.1 市场发展规模
 - 7.2.2 市场竞争形势
 - 7.2.3 半导体技术应用
 - 7.2.4 助推半导体发展
 - 7.2.5 发展趋势分析
- 7.3 医疗设备
 - 7.3.1 市场发展规模
 - 7.3.2 半导体器件发展
 - 7.3.3 半导体技术研发
 - 7.3.4 未来发展前景
- 7.4 车用半导体
 - 7.4.1 市场发展形势
 - 7.4.2 市场产值规模
 - 7.4.3 整体竞争态势
 - 7.4.4 车联网拉动需求

7.4.5 行业并购加速

7.5 半导体照明

7.5.1 产品发展优势

7.5.2 市场发展形势

7.5.3 全球市场现状

7.5.4 中国产业发展

7.5.5 产品价格走势

7.5.6 未来发展前景

第八章 2014-2016年中国半导体产业区域发展分析

8.1 中国半导体产业区域布局分析

8.2 2014-2016年京津渤海区域半导体产业发展分析

8.2.1 区域的发展总况

8.2.2 半导体照明产业

8.2.3 北京市场的发展

8.2.4 石家庄产业发展

8.2.5 大连的产业现状

8.3 2014-2016年长三角地区半导体产业发展分析

8.3.1 区域市场发展形势

8.3.2 产业格局发展成熟

8.3.3 上海打造产业集聚地

8.4 2014-2016年珠三角地区半导体产业发展分析

8.4.1 区域产业发展现状

8.4.2 深圳产业发展现状

8.4.3 东莞建成产业基地

8.5 2014-2016年中西部地区半导体产业发展分析

8.5.1 区域市场发展现状

8.5.2 武汉投建产业基地

8.5.3 重庆产业发展战略

8.5.4 西安半导体产业发展

第九章 2014-2016年国外半导体产业重点企业经营分析

- 9.1 英特尔
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 经营效益分析
 - 9.1.3 半导体业务发展
 - 9.1.4 企业业务投资
 - 9.1.5 转型发展战略
- 9.2 三星
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 经营效益分析
 - 9.2.3 半导体业务发展
 - 9.2.4 市场竞争实力
 - 9.2.5 企业发展战略
- 9.3 高通公司
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 经营效益分析
 - 9.3.3 半导体业务发展
 - 9.3.4 收购动态分析
 - 9.3.5 未来发展战略
- 9.4 海力士
 - 9.4.1 企业发展概况
 - 9.4.2 经营效益分析
 - 9.4.3 企业业务发展
 - 9.4.4 厂房建设动态
 - 9.4.5 对华战略分析
- 9.5 德州仪器
 - 9.5.1 企业发展概况
 - 9.5.2 经营效益分析
 - 9.5.3 产销模式变革
 - 9.5.4 企业发展动态
 - 9.5.5 市场发展战略
- 9.6 东芝
 - 9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 企业动态分析

9.6.4 产品研发进展

9.6.5 未来发展战略

9.7 美国美光

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营效益分析

9.7.3 企业动态分析

9.7.4 企业发展战略

9.8 博通公司

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营效益分析

9.8.3 企业收购动态

9.8.4 产品研发进展

9.8.5 未来发展前景

9.9 英飞凌

9.9.1 企业发展概况

9.9.2 经营效益分析

9.9.3 半导体产业发展

9.9.4 企业收购动态

9.9.5 未来发展战略

第十章 2014-2016年中国半导体产业重点企业经营分析

10.1 展讯

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 经营效益分析

10.1.3 新品研发进展

10.1.4 产品应用情况

10.1.5 未来发展前景

10.2 台积电

10.2.1 企业发展概况

10.2.2 经营效益分析

- 10.2.3 产品研发进程
- 10.2.4 工艺技术优势
- 10.2.5 未来发展规划
- 10.3 日月光
 - 10.3.1 企业发展概况
 - 10.3.2 经营效益分析
 - 10.3.3 企业合作动态
 - 10.3.4 汽车电子封测
- 10.4 联华电子
 - 10.4.1 企业发展概况
 - 10.4.2 经营效益分析
 - 10.4.3 产品研发进展
 - 10.4.4 市场布局规划
 - 10.4.5 未来发展前景
- 10.5 华虹
 - 10.5.1 企业发展概况
 - 10.5.2 经营效益分析
 - 10.5.3 企业发展形势
 - 10.5.4 产品发展方向
 - 10.5.5 未来发展前景

第十一章 中国半导体产业投资分析

- 11.1 产业投资现状
- 11.2 投资并购动态
 - 11.2.1 索尼
 - 11.2.2 软银
 - 11.2.3 ARM
 - 11.2.4 Qorvo
 - 11.2.5 英飞凌
 - 11.2.6 微芯科技
 - 11.2.7 四维图新
 - 11.2.8 福建宏芯

- 11.2.9 赛普拉斯
- 11.2.10 意法半导体
- 11.3 重点投资领域
 - 11.3.1 存储
 - 11.3.2 生产封测
 - 11.3.3 模拟芯片
 - 11.3.4 生产设备
 - 11.3.5 数字芯片SOC
- 11.4 投资风险分析
 - 11.4.1 宏观经济风险
 - 11.4.2 环保相关风险
 - 11.4.3 产业结构性风险
- 11.5 融资策略分析
 - 11.5.1 项目包装融资
 - 11.5.2 高新技术融资
 - 11.5.3 BOT项目融资
 - 11.5.4 IFC国际融资
 - 11.5.5 专项资金融资

第十二章 中国半导体产业未来发展前景及趋势分析（ZY GXH）

- 12.1 中国半导体产业市场发展前景分析
 - 12.1.1 市场前景分析
 - 12.1.2 政策助力发展
 - 12.1.3 晶圆设备需求增长
 - 12.1.4 产业“十三五”规划
- 12.2 中国半导体市场未来发展趋势预测
 - 12.2.1 产业发展趋势
 - 12.2.2 未来发展方向
 - 12.2.3 芯片制造基础提升
 - 12.2.4 国产设备加速替换（ZY GXH）

图表目录：

- 图表1 1988年全球半导体企业销量top20
- 图表2 2003-2014年全球半导体市场需求各地区占比
- 图表3 2015-2017年全球各地区半导体市场规模及增长率
- 图表4 2015年全球8寸晶圆产能分布
- 图表5 2015年全球12寸晶圆产能分布
- 图表6 2014年全球十大半导体设备商市场份额
- 图表7 2014年全球半导体下游应用结构
- 图表8 2011-2016年日本半导体设备BB值
- 图表9 2011-2016年北美半导体设备BB值
- 图表10 2014-2018年全球半导体的资本支出和设备投资规模
- 图表11 2015-2016年各地区半导体材料市场规模
- 图表12 2013-2016年全球晶圆制造与封装材料市场规模
- 图表13 2016年全球半导体企业销量top20
- 图表14 韩国半导体产业政策（一）
- 图表15 韩国半导体产业政策（二）
- 图表16 美国、韩国合作研发的半导体技术
- 图表17 韩国知识经济部支持三星电子和Hynix核心半导体设备开发
- 图表18 韩国20个“名不见经传”的半导体企业。
- 图表19 日本半导体产业的两次产业转移
- 图表20 日本半导体产业发展历程
- 图表21 VLSI项目实施情况
- 图表22 日本政府相关政策
- 图表23 1989半导体芯片市场份额
- 图表24 1990年全球十大半导体企业
- 图表25 韩国DRAM技术完成对日美的赶超化
- 图表26 DRAM市场份额变化
- 图表27 日本三大半导体开发计划的关联
- 图表28 集成电路产业链
- 图表29 2015半导体材料生产份额
- 图表30 半导体材料市场消费份额

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/X05043O3Y5.html>